

お申込みは FAX にて

FAX : 03-3560-3566

TPSS Seminar 資料

急速に進歩を遂げる携帯機器実装技術の中で、パッケージも QFN, WLCSP Stacked Chip Package とメインのパッケージは従来のものと大きく変わっています。

こうした実装技術を考える場合、半導体産業のあるべき姿を認識しつつ、Total Process Solution を追求することが、日本の企業にとって勝ち組となる大切な時期を迎えています。

携帯電話やデジタルカメラ、メモリーメディアなどの実装技術を自分の目で確認し、専門家同士で今後の実装技術を議論する **TPSS (Total Process Solution Study-Group)** が昨年発足しました。この TPSS は、完全なクローズドの任意団体で、企業の壁を超えて自由に技術を討議しています。

商品	セミナータイトル	定価 (税込)		ご希望部数
2004 年 Summer Seminar	NTT DoCoMo 505is / 900i シリーズにおける実装技術	PDF	¥ 33,000-	部
2005 年 Winter Seminar	携帯電話・メモリーメディアにおける 実装技術と TPS	冊子	¥ 15,000-	部
		PDF	¥ 33,000-	部

お名前	
会社名	
ご送付先住所	自宅 会社
請求書ご送付先	個人 会社
E-mail address	
電話番号	

ご購入・お問合せは : E-mail : tpss.spi@semiconportal.com TEL : 03-3560-3565
株式会社セミコンダクタポータル TPSS サテライト事務局
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー東館 17 階
<http://www.semiconductorportal.com>